

第 89 回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 20 年 12 月 5 日(金) 10:30～16:45

場 所：自動車会館（東京 市ヶ谷）

	時 間	題 目	講 演 者
平成 20 年 12 月 5 日 (金)	司 会 芹沢 弘二 (㈱日立製作所)		
	10:30～11:10	『濡れ性に駆動される流れの数値解析』	東京大学大学院 工学系研究科 ○姫野 武洋
	11:10～11:50	『はんだ濡れ上がり試験の解析技術』	FDK 株式会社 ○山中 哲, 袴田和喜 株式会社 富士通研究所 作山誠樹, 清水浩三
	11:50～13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～13:10	委 員 会 議 事	
	司 会 加柴 良裕 (三菱電機㈱)		
	13:10～13:50	『Sn / Ni めっきのはんだぬれ性劣化メカニズム究明』	株式会社 村田製作所 ○野口博司、佐竹学、鎌田信雄
	13:50～14:30	『電解 Ni めっきの高電流密度化による BGA 鉛フリー はんだ接合部の耐衝撃強度向上の検討』	株式会社 ルネサステクノロジ ○山本健一 株式会社 日立製作所 川村利則, 中野 広, 赤星晴夫 大阪大学 佐藤了平
	14:30～14:45	休 憩	
	司 会 大貫 仁 (茨城大学)		
	14:45～15:25	『鉛フリー新めっき皮膜について』	協和電線 株式会社 ○杉江欣也
	15:25～16:05	『鉛フリーはんだ溶湯中に浸せきした鉄基合金の 溶食挙動と界面反応組織』	北海道大学エネルギー変換 マテリアル研究センター ○山内啓, 黒川一哉 株式会社 弘輝 川久保聡, 入澤淳 北海道大学大学院 田中順一
	16:05～16:45	『樹脂から見た電子デバイスのトラブル発生要因の考察』	マイクロ技研 株式会社 ○管野敏之

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。